



# 鸿富诚

专业·专心·专注

创新功能材料领军企业

## HTDG-250 常规系列

### 【可剥离导热凝胶】规格书



-产品图-

#### 应用特点：

- 最薄可剥离的厚度0.15mm
- 高导热性能，低热阻
- 以不定形状替代传统的组装式片材
- 可通过各种手工或自动化的工艺进行点胶
- 相比装配式的片材，可以印制更小的形状特征
- 柔软，可消除应力，减震阻尼
- 固化后可保持所需厚度

#### 应用领域推荐：

- 半导体块和散热器
- 用于LED灯具和发光体、汽车和消费领域
- 点胶或直接涂覆成各种厚度和形状
- 高性能中央处理器及显示卡处理器

#### 应用方式：

可剥离导热凝胶可通过各种方式使用，包括：自动点胶、模版印胶和手动涂覆。

#### 包装：

根据不同需求，可以按照30cc/55cc/300cc等容量，按灌注方式包装。

该系列产品环保符合RoHS2.0、卤素、REACH标准。

**储存条件：**密封冷藏，

储存温度：0~10℃；

**保质期：**

在4℃储存条件下：6个月

#### 产品性能

NO.	参数	单位	测试方法
颜色	白色	--	目视
状态	低粘度流体	--	--
粘度	350	pa.s	7#转子
挤出速率 @0.5Mpa	2	g/min	14#锥形针头
密度	2.8	g/cc	ASTM D 792
静态压缩应力	≤1 (@50%)	Psi	GB/T 7757-2009
粘接力	≤15	Psi	--
固化时间	25℃	96	h
	80℃	3	h
	120℃	20	min
	150℃	5	min
硬度	50(±5)	Shore C	ASTM D 2240
拉伸强度	≥0.4	Mpa	ASTM D 412
延伸率	≥200	%	ASTM D 412
撕裂强度	≥1.5	N/mm	ASTM D 624
压缩率	≥20 (@60Psi)	%	ASTM D 575
使用温度	-50~150	℃	IEC 60068-2-14
防火性能	V0	--	UL-94

#### 热学特性

导热系数	2.5	W/m·K	ASTM D 5470
------	-----	-------	-------------

#### 电学特性

击穿电压	≥10	KV/mm	ASTM D149
体积电阻率	≥10 <sup>13</sup>	Ω.cm	ASTM D 257
介电常数	≥2	@1MHz	ASTM D 150
介质损耗	≤0.1	@1MHz	ASTM D 150

以上数据由鸿富诚实验室提供，该实验室保留最终解释权